

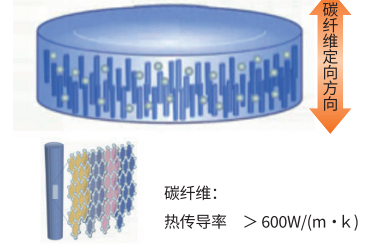
# 高热传导性导热片

本导热片采用本公司特有的磁场定向技术,利用碳纤维具有的高热传导率,同时实现聚合物的柔韧性以及粘性。

可实现 CPU、GPU 以及高能量密度的 LED 等高发热部位的冷却,低分子量硅氧烷含量被控制在 70ppm 以下,因此可以在开关等接点附近使用。

利用聚合物的粘性实现双面粘合,是具有良好的固定性和追从性的高热传导型导热片。PT-V 为高定制性产品,可以调整硬度、操作性等各种指标。

【导热片示意图】



## 各种特性

项目	单位	品名	STCS-6J	STCS-6	STCS-9	STCS-12	STCS-15
特征	—		双面粘合	双面粘合	双面粘合	双面粘合	双面粘合
基础聚合物	—		a- 烯烃	硅胶	硅胶	硅胶	硅胶
热传导率 <sup>*1</sup>	W/(m·K)		6	6	9	12	15
硬度	TypeE		40	30	23	30	35
	TypeOO		70	55	45	55	60
比重	—		1.9	1.8	2.1	2.4	2.3
体积电阻率 <sup>*2</sup>	$\Omega \cdot \text{cm}$		$\geq 1 \times 10^{10}$	$\geq 1 \times 10^{10}$	$\geq 1 \times 10^{10}$	$\geq 1 \times 10^{10}$	$\geq 1 \times 10^6$
绝缘击穿强度 <sup>*2</sup>	AC kV/mm		0.7	1.0	0.7	0.9	0.5
阻燃性	UL 94		V-0	V-0	相当于 V-0	V-0	相当于 V-0
厚度	mm		0.5 ~ 3.0	0.5 ~ 3.0	0.5 ~ 3.0	0.5 ~ 3.0	0.5 ~ 3.0
使用温度范围	°C		-40 ~ 120	-40 ~ 150	-40 ~ 150	-40 ~ 150	-40 ~ 150

※1 热传导率适用 ASTM D5470 标准,在压缩 20%的情况下进行测定。

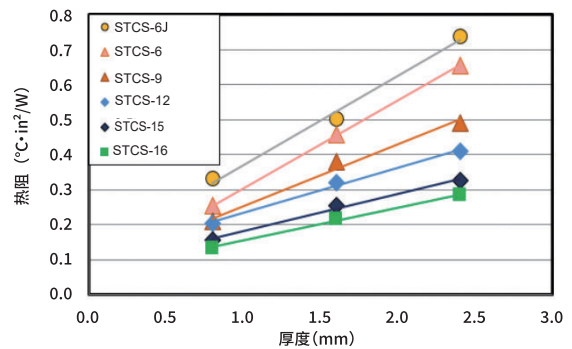
※2 体积电阻率是在 1mm、10%压缩时的测定值。本产品添加了碳纤维,每个厚度规格均发生趋势变化,请根据用途确认电气特性。

※ PT-UZ、PT-V II 的规格若有变更,恕不另行通知。

## STCS-12 定制规格

产品名称	STCS-12	STCS-12M	STCS-12S
外观			
特征	正常规格 双面粘合	内置网格 操作性提高 双面粘合	带单面膜 操作性提高 单面完全不粘合 绝缘性增强
5kgf 热阻 (0.25t) °C/W	0.42	0.62	0.83
绝缘击穿强度 (1t) kV/mm	0.9	—	2.0

## 热阻比较



适用 ASTM D5470 标准 20%压缩时的热阻值

※图、表中的测定值为实测值,并非产品标准值。